

狭隣接実装基板

特徴

- ・0201の実装技術を確立。パターン設計、基板、実装のソリューションを提供
- ・0402実装の部品間ピッチ0.15mmまでの狭隣接実装技術を確立
- ・BGA-BGA間ピッチ0.10mmまでの実装技術を提供

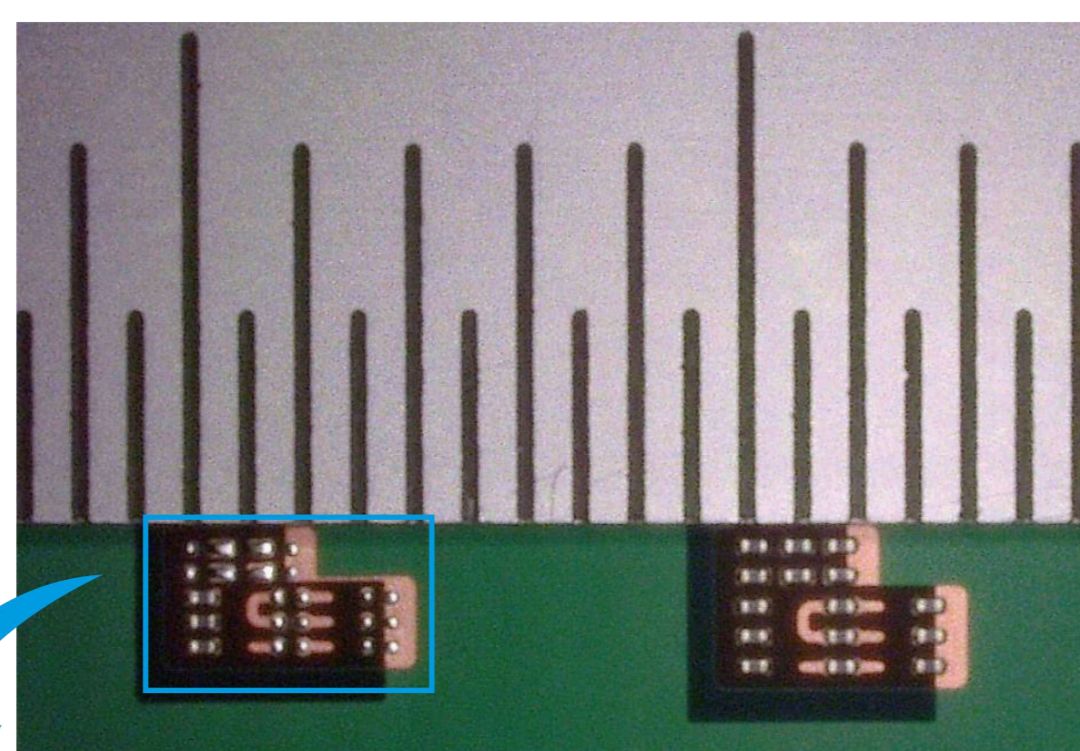
用途

- ・モバイル端末
- ・PC周辺機器
- ・業務用無線機
- ・車載機器
- ・各種センサ基板

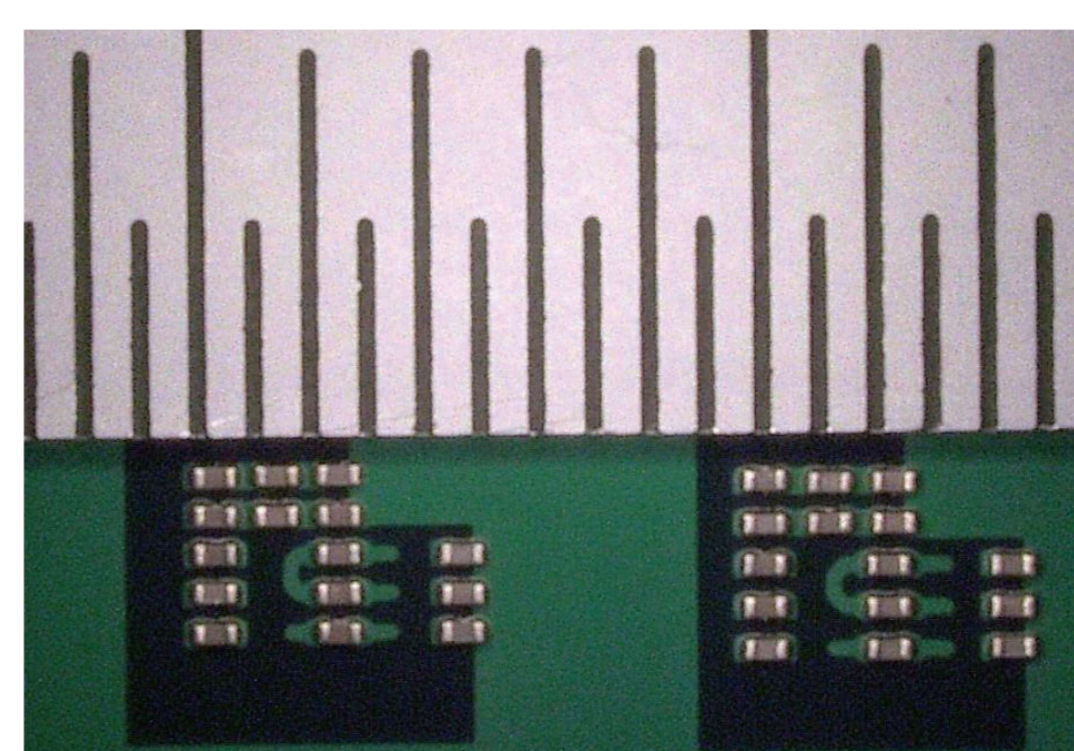
構造・仕様

昨今、高密度実装化が加速し、BGAの0.3mmピッチ等を筆頭に電子部品の微細化がさらに加速している。プリント配線板においては、ビルドアップ基板の多層化が進み、電子部品のパッドに対するフィレットレス化も身近になってきた。0402チップが主流になりつつある現在、更なるダウンサイジングのニーズは限定的とみられるが、次世代に向け、0201チップの実装技術、および0402チップの狭隣接実装を確立する。

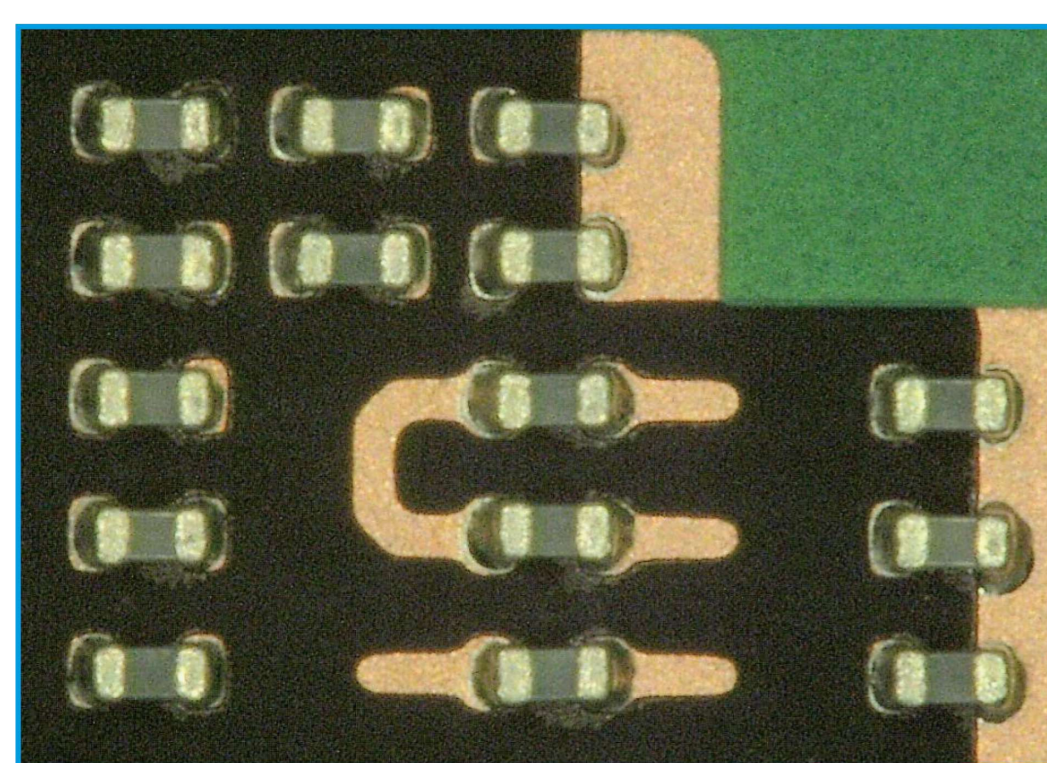
実装例(チップ)



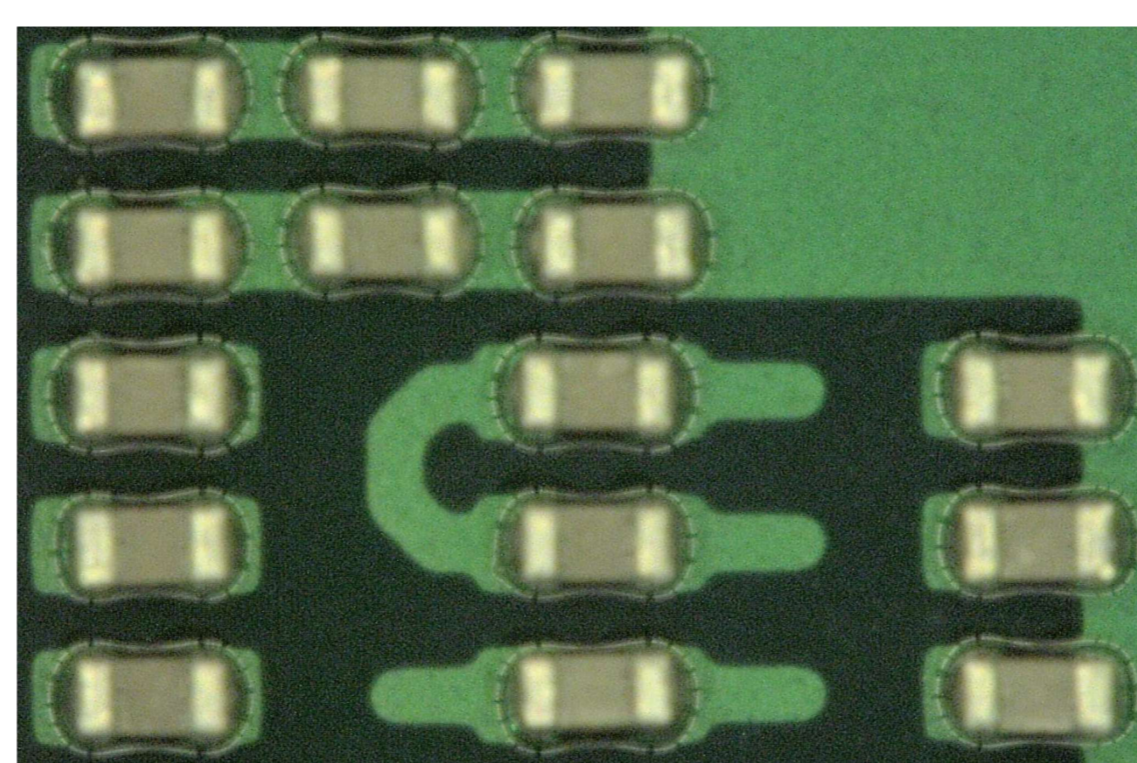
0201チップ部品間隔:0.15mm



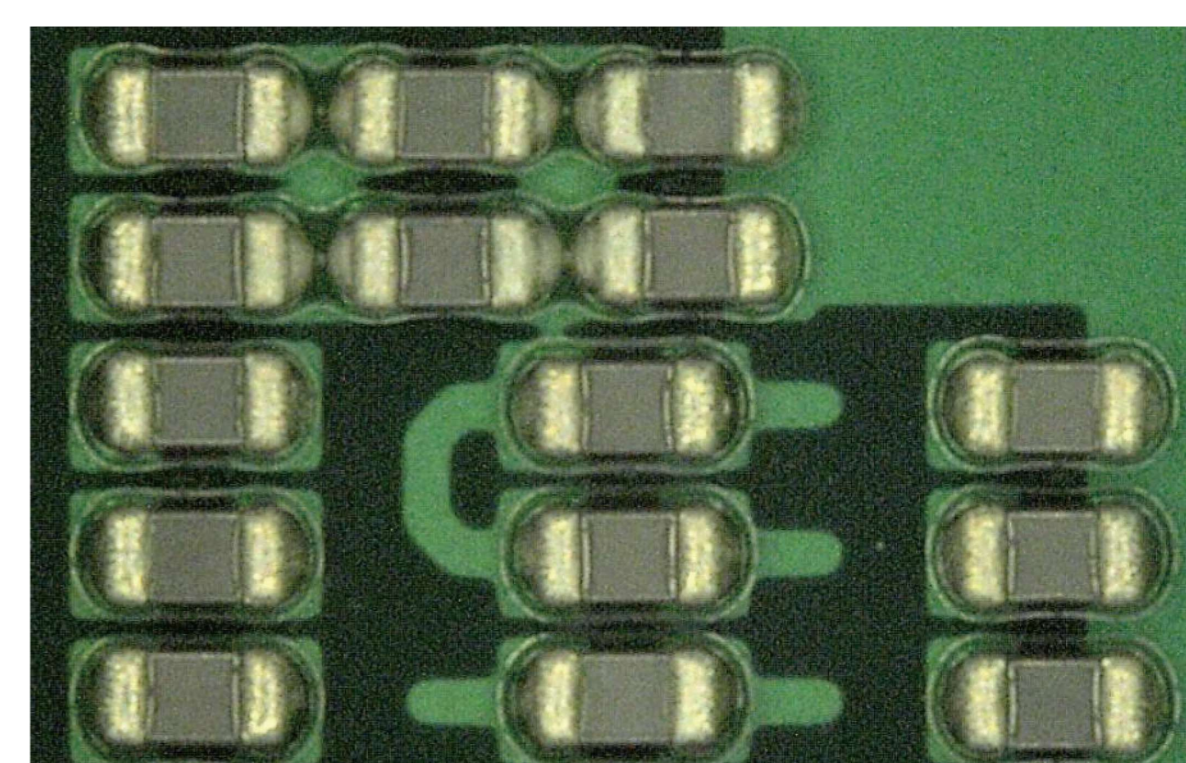
0402チップ部品間隔:0.15mm



0201チップ

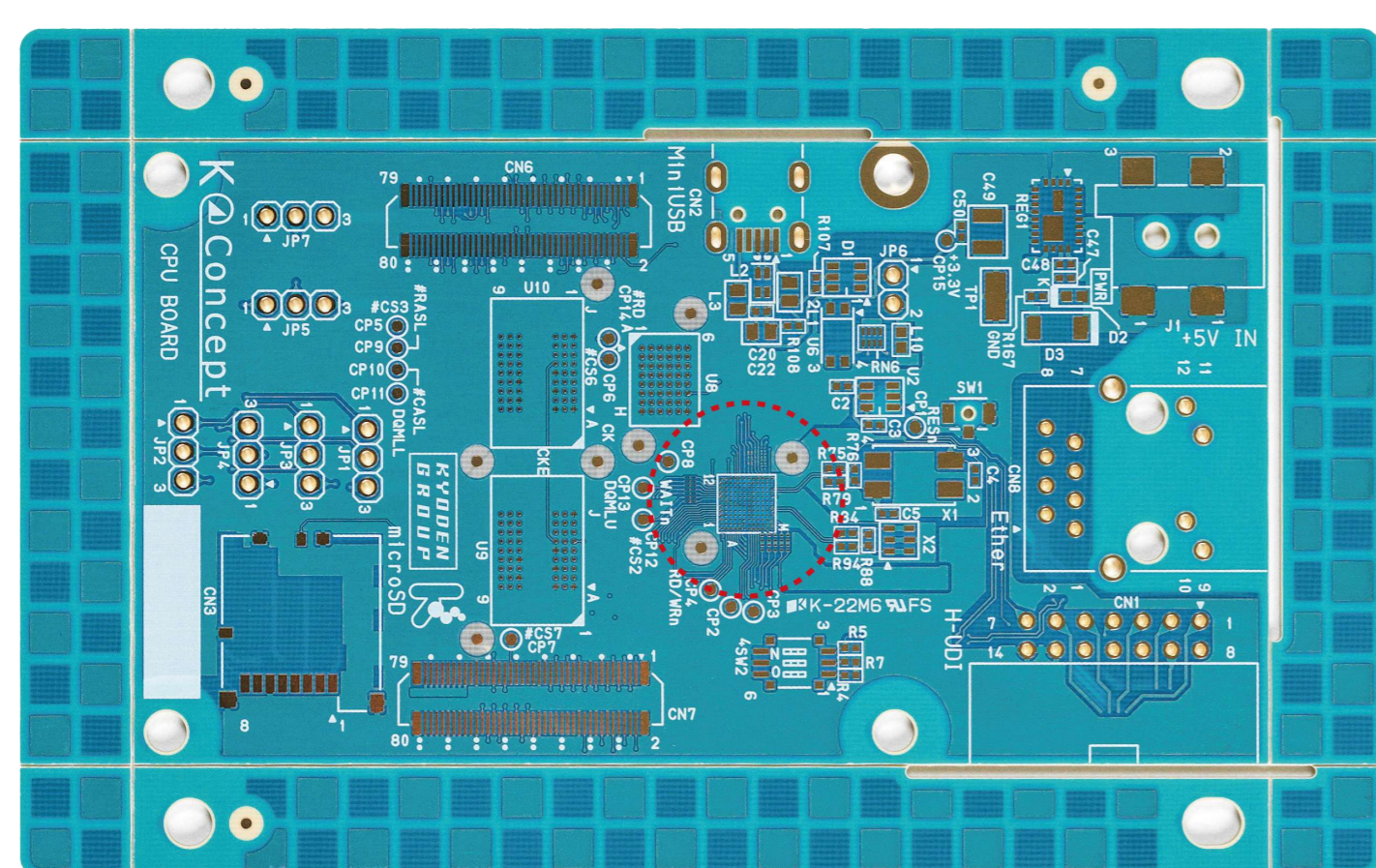


0402チップ

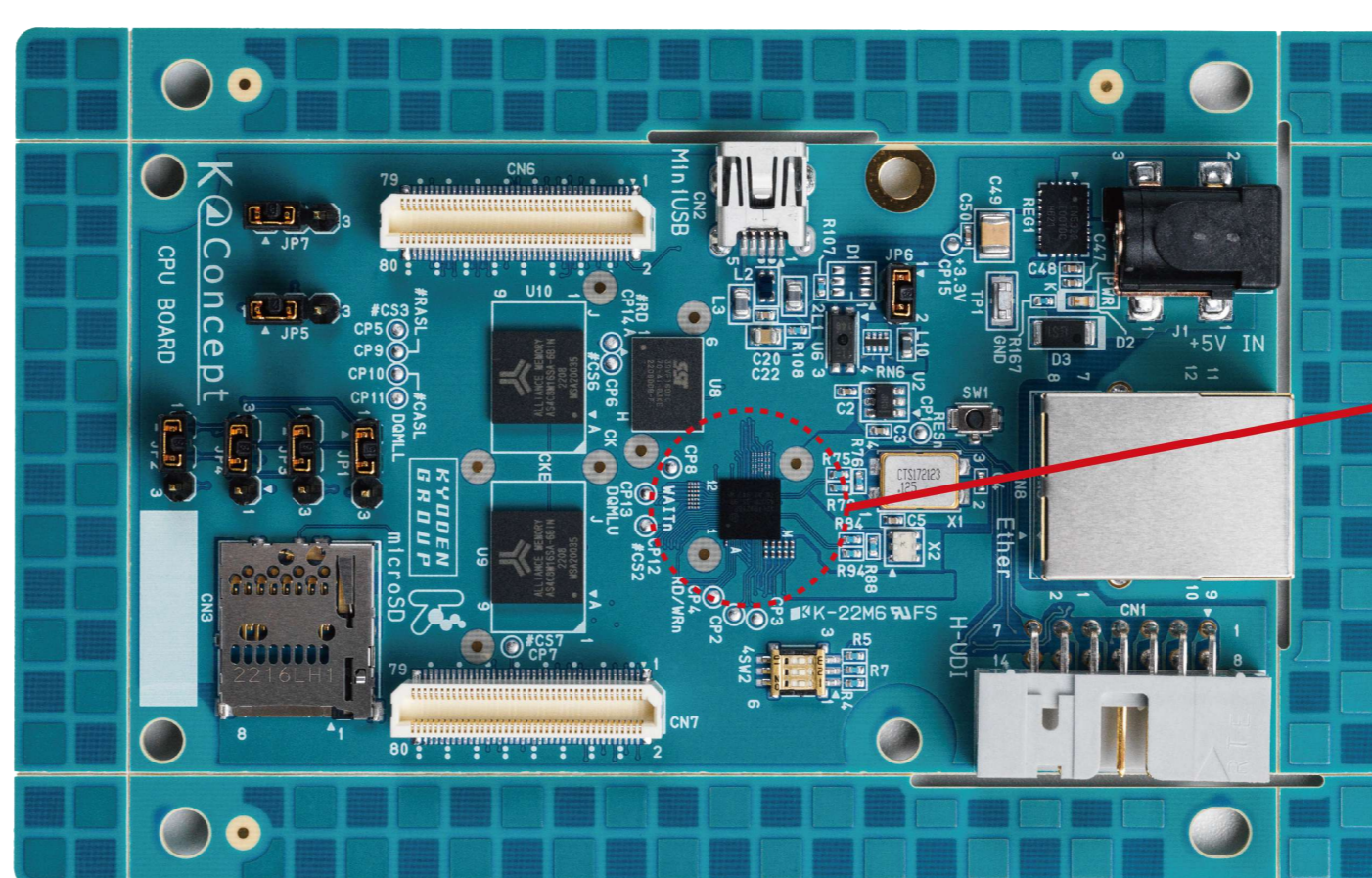


0603チップ

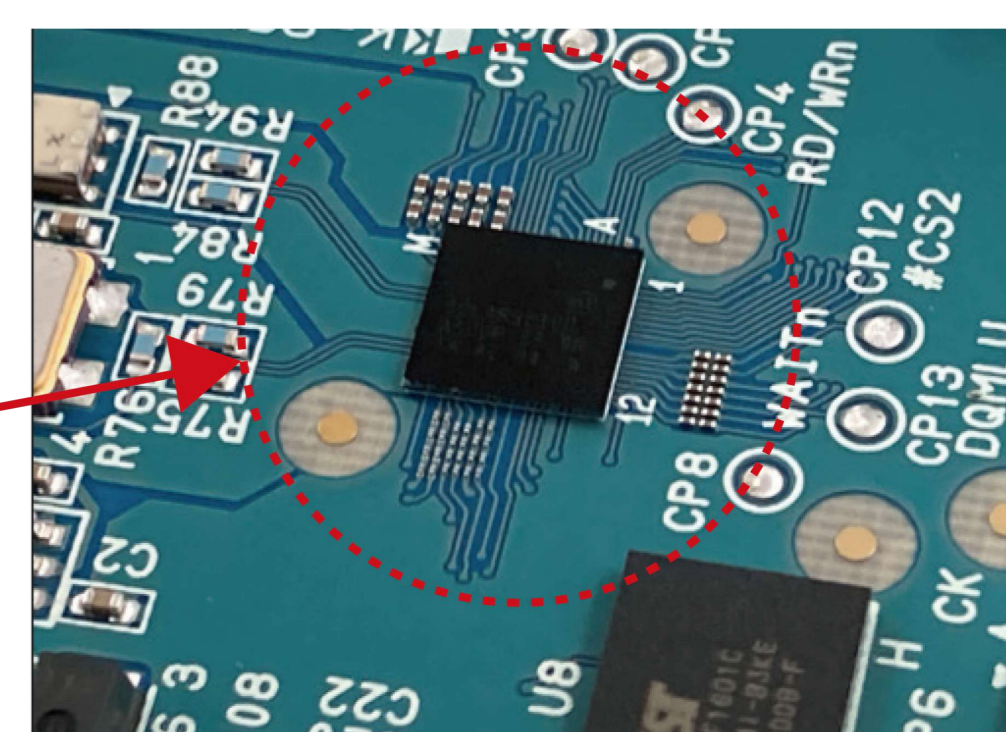
実装例(BGA)



0201チップ 0402チップ 生板



0201チップ 0402チップ 部品実装



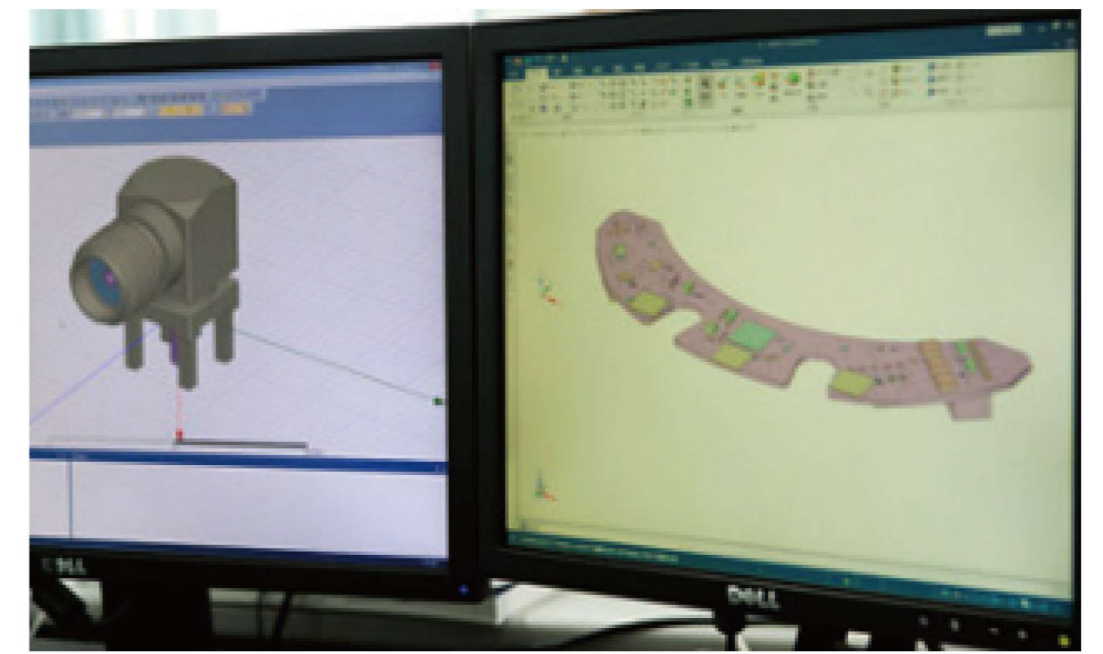
BGA拡大部
顕微鏡でご確認ください

メカニカルユニット

メカ設計及び板金加工(プレス・レーザー・プレスブレーキ)、
樹脂成形・切削加工で加工した部品を組み合わせた、
完成品(半完成品)までの部品製造・製品組立てまで対応します。

メカ設計

ラフなスケッチからでも経験豊富なエンジニアがヒヤリングさせて頂きイメージを具現化します。
3DCADを用いた筐体設計、機構設計、試作設計、強度設計を用いて行います。



板金加工 (プレス)

匠の技術で金型の設計をはじめとして、試作から量産へのスムーズな移管をご提案いたします。
また、表面処理(めっき・塗装)・組立まで、一貫生産でお応えします。



板金加工

複合ファイバー
レーザー
プレスブレーキ

金属材料毎の異なる特性を考慮、数多くの経験をもとに最新鋭の設備を自由自在に使いこなし高精度部品に加工します。精密・薄物・筐体板金・各種溶接・仕上加工までを小ロットから大口ロット生産までお手伝いします。



射出成形

少ロットから大口ロットまで、短納期かつローコストのニーズに対応します。
非球面の光学部品も製造しており、高精度成形技術、他光学系でも対応が可能です。



切削

高い信頼性が要求される金属加工部品を、精度・素材・コスト・納期を重視して生産します。鉄、アルミニウム、ステンレス、銅など幅広い材料に対応します。

